

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2015-016

天水华天科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
传真	0938-8630216	0938-8632260	
电子信箱	htcwy2000@163.com	ycp@tsht.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,305,481,665.85	2,447,163,304.12	35.07%	1,623,202,273.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,183,078.68	199,164,273.88	49.72%	121,035,150.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,840,143.11	188,336,248.82	32.13%	70,153,712.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	553,145,925.08	387,657,463.67	42.69%	214,506,255.89
基本每股收益（元/股）	0.4483	0.3065	46.26%	0.1863
稀释每股收益（元/股）	0.4483	0.3065	46.26%	0.1863
加权平均净资产收益率	14.72%	12.20%	2.52%	8.16%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	4,158,051,847.50	3,559,009,701.15	16.83%	2,555,439,760.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,254,103.98	1,775,685,711.05	35.57%	1,523,632,824.47

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

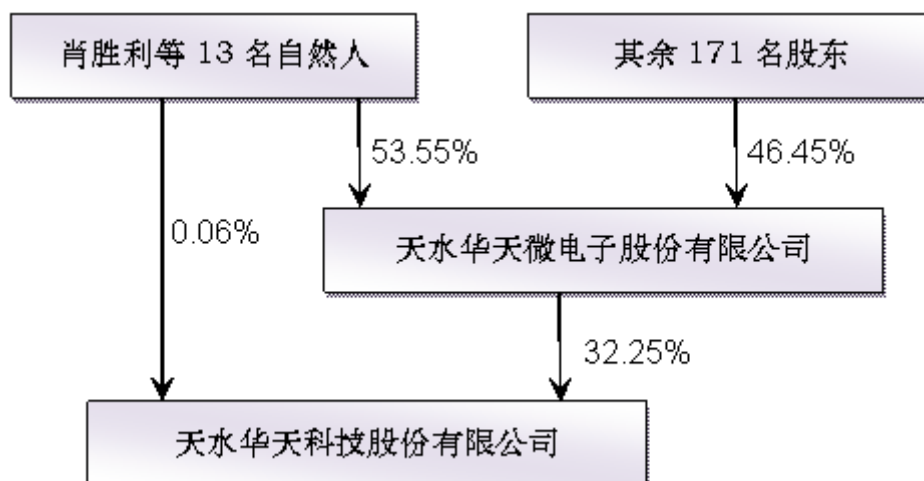
报告期末普通股股东总数	39,345	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股 股东总数	34,702			
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	32.25%	224,827,520	0	质押	3,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资 基金	其他	2.30%	16,000,053	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.65%	11,486,188	0		
中国工商银行－博时第三产业成长股票 证券投资基金	其他	1.43%	9,999,940	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 混合型证券投资基金	其他	1.14%	7,979,165	0		
交通银行－中海优质成长证券投资基金	其他	0.75%	5,249,927	0		
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	0.72%	5,000,006	0		
全国社保基金六零一组合	其他	0.70%	4,847,593	0		
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动 股票型证券投资基金	其他	0.68%	4,774,251	0		
中国民生银行股份有限公司－长信增利 动态策略股票型证券投资基金	其他	0.68%	4,739,745	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期末，国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司 9,173,659 股股份，占公司总股份的 1.32%；华泰证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,625,788 股 股份，占公司总股份的 0.95%；招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司 5,867,531 股股份，占公司总股份的 0.84%；国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司 5,437,317 股股份，占公司总股份的 0.78%。以股东通 过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股 东情况如上表所示。上述前 10 名股东在报告期末未通过投资者 信用账户持有公司股份。				

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2014年随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布和千亿级集成电路产业投资基金的设立，进一步凸显了集成电路产业的战略性、基础性、先导性产业地位，充分体现了集成电路产业在国民经济和社会发展以及保障国家信息安全方面的重要性，使得国家对集成电路产业的政策和资金支持达到了前所未有的状态，良好的产业政策和资金支持以及广阔的市场需求，必将促进我国集成电路产业进入又一轮的快速发展周期。

根据中国半导体行业协会统计，2014年我国集成电路产业销售额为3,015.4亿元，同比增长20.2%，其中设计业销售额为1,047.4亿元，同比增长29.5%，制造业销售额为712.1亿元，同比增长18.5%，封装测试业销售额为1,255.9亿元，同比增长14.3%。另据海关统计，2014年我国进口集成电路2,856.6亿只，同比增长7.3%，进口金额2,184亿美元，同比下降6.9%，出口集成电路1,535.2亿只，同比增长7.6%，出口金额610.9亿美元，同比下降31.4%。

2014年公司紧紧抓住我国集成电路产业发展的大好机遇，稳步推进《40纳米集成电路先进封装测试产业化》项目和《通讯与多媒体集成电路封装测试产业化》项目的实施，加大02专项和研发项目的实施以及技术开发力度，积极实施并购重组，使公司集成电路封装能力和技术水平都得到了切实有效的提高，2014年公司保持了持续快速发展的良好势头。

①2014年公司共完成集成电路封装量106.96亿只，同比增长27.79%，实现营业收入33.05亿元，同比增长35.07%，净利润3.06亿元，同比增长52.37%，其中归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长49.72%。

②公司所承担的国家科技重大专项02专项《多圈V/UQFN、FCQFN和AAQFN封装工艺技术研发及产业化》项目实施完成并顺利通过验收，启动实施了《阵列镜头智能成像TSV-CIS集成模块工艺开发与产业化》等四个02专项项目（课题），02专项项目的有效实施，切实提高了公司技术水平和研发能力。

③积极推进并购重组和股权收购工作，2014年进行了FlipChip International, LLC公司及其子公司100%股权的收购工作，完成了GENTEC INVESTMENT LIMITED持有的华天昆山16.15%股权的收购，通过海外并购和股权收购，进一步完善了公司产业发展布局，有效推进了公司国际化进程。

④随着FC、指纹识别、MEMS、Bumping等集成电路高端封装产品研发成功和封装规模的不断扩大，公司产品结构进一步优化，市场竞争能力进一步提高。

⑤可转债顺利实现转股，切实降低了公司的资产负债率，优化了公司的财务结构，提高了公司的抗风险能力。

(2) 主营业务分析

2014年公司主营业务为集成电路封装测试，全年实现营业收入33.05亿元，同比增长35.07%；归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长49.72%。

单位：元

项目	2014年	2013年	变动比例（%）
营业收入	3,305,481,665.85	2,447,163,304.12	35.07%
营业成本	2,581,946,965.63	1,920,188,995.93	34.46%
销售费用	42,090,148.61	36,438,094.82	15.51%
管理费用	352,118,706.93	241,791,327.60	45.63%
财务费用	28,331,902.64	33,905,777.43	-16.44%
研发支出	230,256,635.10	144,740,096.73	59.08%

变动原因分析：

①营业收入和营业成本分别较上期同比增长35.07%和34.46%，主要原因是本报告期产能较上年稳步增长，产能利用率提高，销售额较上年增加，且本报告期较上年多合并华天昆山8个月的收入和成本所致。

②销售费用较上期同比增长15.51%，主要原因是本报告期产品运输费与职工薪酬较上年增加所致。

③管理费用较上期同比增长45.63%，主要原因是本报告期研究开发费用与职工薪酬较上年增加所致。

④财务费用较上期同比下降16.44%，主要原因是本报告期利息支出较上年减少，利息收入较上年增加所致。

⑤研发支出较上期同比增长59.08%，主要原因是公司进一步加大了技术研发项目和02专项的实施力度，新产品、新技术、新工艺开发支出不断增加，且本报告期较上年多合并华天昆山8个月研发支出所致。

(3) 核心竞争力分析

①技术优势

公司依托国家级企业技术中心、甘肃省微电子工程技术研究中心、甘肃省微电子工程实验室等研发验证平台，通过承担国家科技重大专项02专项等科技创新项目以及新产品、新技术、新工艺的不断研究开发，自主研发出BGA、FC、Bumping、MEMS、指纹识别、V/UQFN、AAQFN、MCM（MCP）、SiP、TSV等多项集成电路先进封装技术和产品，随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断提升。

②成本优势

公司地处西部地区具有较低的人力资源成本，土地使用、生产动力等方面的价格也相对较低，使公司具有国外以及国内沿海地区集成电路封装企业所无法比拟的成本优势。随着公司集成电路封装规模的不断扩大以及成本管控的持续开展，公司在成本方面的竞争优势将进一步得到加强和巩固。

③市场优势

公司拥有稳定的客户群体和强大的销售网络，通过多年的合作，公司得到了客户的广泛信赖，为公司发展提供了有力的市场保证，降低了市场风险。今后，公司在稳定扩展国内市场的同时，进一步加大海外市场的开发力度，促进公司持续快速发展。

④管理团队优势

公司拥有一支善于经营、敢于管理、勇于开拓创新，团结向上的经营管理团队；公司法人治理结构完善，各项管理制度齐全；多年的大生产实践，公司已形成了一套先进的大生产管理体系。

（4）公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势

A、行业竞争格局

国内集成电路封装测试业的企业构成明显呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，由飞思卡尔(Freescale)、英特尔(Intel)、松下(Panasonic)、意法半导体(ST)、瑞萨(Renesas)、英飞凌(Infineon)、日月光(ASE)等国际大型半导体企业在华投资设立的封装测试企业，无论是在规模上还是在技术水平上均相对领先于国内封装企业。近几年来，在国家科技重大专项02专项的推动下，国内集成电路封装企业不断加大技术改造和技术研发，产业规模不断扩大，封装技术水平快速提高，部分集成电路先进封装技术水平已逐步接近和达到国际先进水平，整体竞争实力显著提高，产业并购整合步伐明显加快。

未来随着国家对集成电路产业扶持力度和投资力度的不断加大，国内集成电路产业链将不断完善，产业整体发展速度将进一步加快，依据国内旺盛的市场需求和良好的政策环境，国内集成电路封装企业将加快赶超国际先进水平的步伐，与国际先进集成电路封装企业之间的差距将快速缩小，参与国际市场的竞争能力不断加强，国内集成电路封装企业与国际半导体封装巨头之间的竞争将不断加剧。

B、行业发展趋势

集成电路作为当今信息技术产业高速发展的基础和源动力，已高度渗透与融合到国民经济和社会发展的每个领域，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。基于集成电路对国民经济和国家安全的重要性，2014年我国政府颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，并设立了国家集成电路产业投资基金，使全球集成电路产业发展的目光又一次聚集我国，掀起了我国集成电路产业发展热潮，集成电路产业很可能成为我国下一个在全球崛起的产业。

旺盛的国内市场需求是我国集成电路产业发展的强大动因，使我国成为全球最大和增长最快的集成电路市场，《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布和国家集成电路产业投资基金的设立，必将加快我国集成电路产业的进一步快速发展。未来，在智能移动终端、可穿戴设备、物联网、移动支付、汽车电子等多样化应用的驱动下，我国集成电路产业将进入新一轮的快速发展时期，继续成为引领全球集成电路市场增长的火车头，带动全球集成电路产业增长。

随着国家集成电路产业投资基金项目投资启动，将进一步引领国内集成电路产业投资热潮，并以此推动国内集成电路龙头企业的并购重组，带动整个集成电路产业的大整合，国内集成电路龙头企业通过自身的发展和并购重组，逐步跻身全球第一梯队，集成电路制造工艺将达到国际主流水平，并以此带动我国集成电路产业整体发展，集成电路国产化替代进程将加快推进。根据中国半导体行业协会（CSIA）、中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，到2016年我国集成电路市场需求规模将超过1.2万亿元，国内集成电路产业收入将达到3700亿元以上，顺应集成电路产品向功能多样化的发展趋势，BGA、CSP、MCM、WLP、FC、3D、TSV等先进封装技术和产品将是今后集成电路封装发展的重点。

②未来发展战略

公司将坚持以发展为主题，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新，在扩大和提升现有集成电路封装业务规模与水平的同时，大力发展BGA、CSP、MCM（MCP）、SiP、FC、TSV、MEMS、LED、Bumping等高端封装技术和产品，扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值，努力提高市场份额和盈利能力。在加快自身快速发展的同时，有效实施并购重组和股权收购工作，通过并购重组以及资源整合，不断完善公司产业发展布局，稳步推进公司国际化进程，以期取得跨越式发展。

加大高层次管理技术人才的引进力度，着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售方面具有竞争优势的高素质、业务娴熟的骨干队伍，以持续不断的技术和产品创新，提高企业的核心竞争力，将公司发展成为国际知名的集成电路封装测试企业，打造中国集成电路封装测试行业的第一品牌。

③下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素分析

A、2015年度生产经营计划

根据行业特点和市场预测，2015年度公司生产经营目标为全年实现营业收入40亿元，生产经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客

户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

2015年主要开展以下工作：

a、全面完成《40纳米集成电路先进封装测试产业化》项目和《通讯与多媒体集成电路封装测试产业化》项目实施，切实提高公司集成电路封装能力和市场竞争能力，确保公司持续稳定发展。

b、切实做好收购FCI及其子公司100%股权的交割工作，加快FCI及其子公司在技术和市场方面的资源整合和有效利用，以此推进公司在高端封装技术产业化进程和国际市场的开拓。

c、进一步扩大指纹识别、MEMS、Bumping、12"TSV-CIS等集成电路封装产能，不断提高集成电路高端封装产品占比及市场份额，增加公司发展后劲，适应和满足集成电路产业快速发展的趋势和需求。

B、未来面对的风险因素分析

a、受半导体行业景气状况影响的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。另外，随着集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。

b、产品生产成本上升的风险

公司产品主要原材料的价格与黄金、铜的价格走势密切相关。如果黄金与铜的价格变化存在较大的波动，从而会导致公司经营业绩出现一定的波动。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

针对上述风险，公司未来将继续优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

c、技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展热点和用户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

C、发展规划资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司2015年发展规划资金需求主要为募集资金投资项目实施所需资金，日常生产经营和技术产品研发以及市场开发等方面所需营运资金，资金来源主要为募集资金、自有资金及银行贷款。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，因执行新企业会计准则导致的会计政策变更情况如下：

2014年初，财政部分别以财会【2014】6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会【2014】23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经公司第四届董事会第十三次会议于2014年10月27日决议通过，公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》，本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》将公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》，公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，期初、期末重分类到可供出售金融资产的金额为2,100万元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

①2014年11月24日，公司在香港设立全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司，注册资本为10,000.00美元。并已取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2172417）。截止2014年12月31日，公司对华天香港的出资尚未到位。期末公司将华天香港纳入合并范围。

②2014年12月31日，华天香港已完成其全资子公司Huatian Technology (USA) LLC在美国的登记注册，公司名称为Huatian Technology (USA) LLC。税务登记号36-4801540，税务登记证上的注册资本4,200万美元。截止2014年12月31日，华天香港对其全资子公司的出资尚未到位。期末公司将全资孙公司Huatian Technology (USA) LLC纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一五年三月十日